



SPRS TECHNOLOGIES

P/N: STBP6R1-0R3-D463

Thin Film Planar Filters

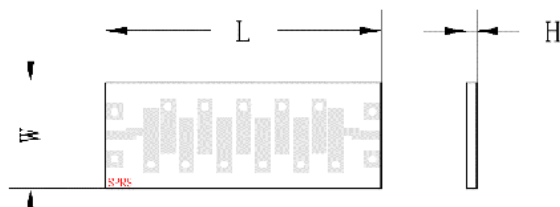
## 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

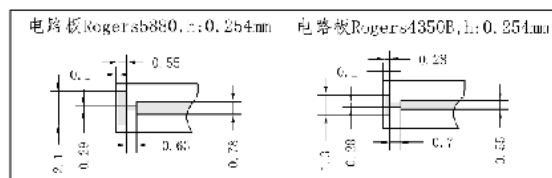
技术要求,  $T_A = 25^\circ\text{C}$

| 参数               | 最小   | 典型  | 最大   | 单位               |
|------------------|------|-----|------|------------------|
| 中心频率             |      | 6.1 |      | GHz              |
| 工作频率             | 5.95 |     | 6.25 | GHz              |
| 中心损耗             |      | 4.5 | 5.0  | dB               |
| 带内波动             |      | 0.5 | 1.0  | dB               |
| 回波损耗             | 12   | 15  |      | dB               |
| 带外抑制@DC-5.4GHz   | 40   | 43  |      | dBc              |
| 带外抑制@6.8-14.0GHz | 40   | 43  |      | dBc              |
| 承受功率             |      |     | 20   | dBm              |
| 工作温度             | -55  |     | +85  | $^\circ\text{C}$ |
| 储存温度             | -55  |     | +125 | $^\circ\text{C}$ |

外形图: L: 8.0, W: 5.5, H: 0.254, 端口居中



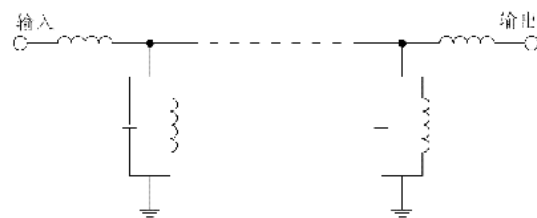
## 推荐装配图:



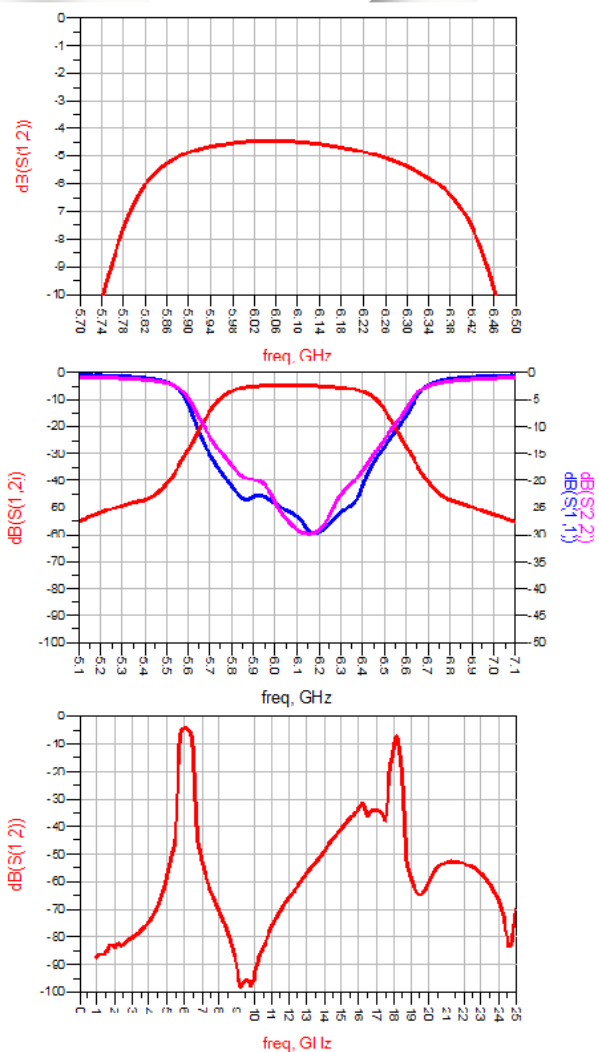
## 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁0.1mm，表面距上盖2.75mm，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$ )，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配；

## 原理图



## 典型曲线, $T_A = 25^\circ\text{C}$



Tel: 18349127722

Fax: +86 28-80566718

Email: pengxiaojun@cdsprs.com

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

官网 www.com-mw.com

商城 www.dianzibuy.com

电话 15608095669

邮箱 sales@com-mw.com

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。